

ポリイミドレジンボンド セプラックス

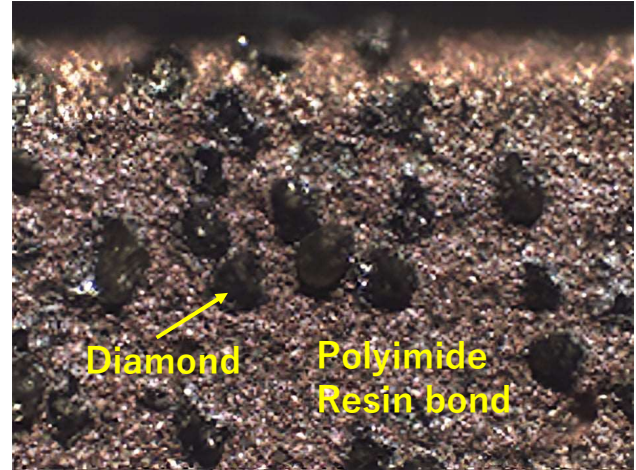
# CEPLAX<sup>®</sup> BLADE

各種被削材に合わせ開発した当社独自のポリイミドレジンボンドブレードです。

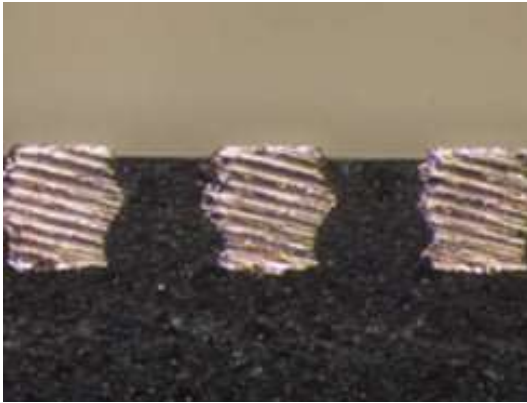
超耐熱樹脂ポリイミドをボンドに使用することより熱劣化が少ない。ポリイミド樹脂は剛性が非常に高いため耐磨耗性や形状維持に優れています。

用途 CSP基盤/ガラス等/CMOS基盤/セラミックス/超硬等

特徴 チッピング低減/超研削性

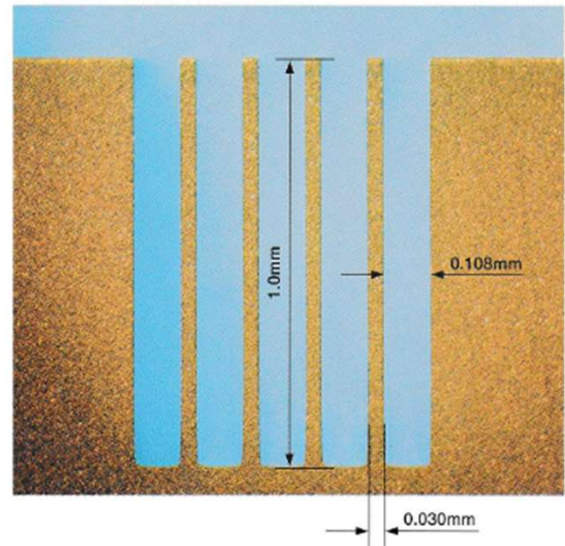


## QFN ダイシング with CEPLAX BLADE



切断でのポイント：リードが外周部の端子に無いことが特徴であり、切断面の端子である銅のバリ（端子間距離）制御が重要となります。

## 超硬合金の微細溝入れ加工例



EX. : SD600-25-CX48 56D/0.1T/40H						
Abrasive type	Grit	Concent	Bond	OD	Thick	ID
SD	600	25	CX48	56D	0.1T	40H
SD	#2000	15-125	CX48 (↑HARD)	Φ46mm~ 80mm	0.1~0.5mm	40H
SDC	#1500		CX88			
CBN	#1200		CX4N			
	#1000		CX8N (↓SOFT)			
	#800					
	#600					
	#500					
	#400					
	#325					
	#270					
	#230					



新日産ダイヤモンド工業株式会社  
YOKOHAMA JAPAN

販売窓口 ユーウィン株式会社

<http://www.uwin-g.co.jp/>